

- 1) 如板内无定位孔, 可在附近加定位孔; 如无附近, 而又需要添加定位孔时, 需要确认。
- 2) V-CUT 余厚没有要求时, **板厚 1.6, 余厚按 0.45+/-0.1mm**, 其余板厚, 余厚则直接根据 MI 规范处理。(工程需在 ERP 中 V-CUT (含“跳 V-CUT”) 工艺备注中加入“V 槽深度 $\geq 0.1\text{mm}$ ”的要求, 对于板厚 $\leq 0.6\text{mm}$ 的板若要求双面 V-CUT 需走难度板评审流程)
- 3) 对金手指倒角没有特殊要求, 按公司默认要求制作。
- 4) 孔盘等大时, 需按客户定义的属性制作, 不允许更改孔属性。
- 5) 上下线路层没有焊盘, 没有任何电性能连接的 PTH 孔可以按照 NPTH 孔来制作。
- 6) 板边允许削铜 2MIL 以内, 超过 2mil 需要与顾客确认; 允许移线 2MIL 范围内, 否则需要确认
- 7) 顾客特殊要求除外, **拼版附近上加实心铜皮** (镀金板除外, 对镀金板附近内层加实心铜皮, 外层不加任何铜)

- 8) 文件没有特别要求; 沉锡厚度按最小 1UM, 蓝胶厚度为 0.40-1.0MM。
- 9) 孔铜按 IPC3 级控制, 即最小 20、平均 25UM。面铜按 IPC3 级控制
- 10) 验收标准: 按顾客要求填写 IPC-A-600 II 级 或 IPC-A-600 III 级(文件中没有说明默认按 IPC-A-600 II 级)
- A. IPC-A-600 II 级标准, CAM 在 ERP 终检工序特殊要求栏还需填“NCAB 顾客协议”
- B. IPC-A-600 III 级标准, 对应 NCAB 有两种特殊要求 (NCAB Level 2 或 NCAB Level 3), 预审通过预审指示给到 CAM 具体采用哪一种, CAM 在 ERP 终检工序特殊要求栏还需填“NCAB Level 2”或“NCAB Level 3”, 并在 Panel 的空余位置增加标准的测试图形供生产打切片使用
- 11) 客户设计的板若存在有贴片安装的, 必须提供贴片文件给到客户, 贴片文件的命名为文件名+P (如 4WA2606P.ZIP, 留意文件名为客户的文件名)。
- 12) 对于 NCAB 全套引用资料订单, 工程必须要核对 ERP 指示库和 PCB 通知单, 对于矛盾问题必须要提出反馈确认。
- 13) 若客户说明 Inner radius(contour) 1.2mm, 则工程按照半径为 1.2mm 做倒圆角。
- 14) 沉金(Au 0.05-0.1um, Ni 3-5um), 水金 (Au 0.025-0.075um, Ni 3-5um), 若客户参数超出此要求, 我司可以按照正常参数制作

- 15) 当文件中存在字符上焊盘，若有空间，就移开，若没有，我司可刮掉它。

- 1.6) 钻孔文件中的数量与钻孔图数量不一致时, 按照原文件制作。